

LED/ICダイ・アタッチ用 導電性Ag樹脂ペースト MD-2000

主な用途

- ・ High-Power LED
- ・ 小型IC

特徴

- ・ 1液無溶剤型
- ・ 糸引き、液だれのない優れた作業性
- ・ 高接着力、高導電性

一般特性

ペースト特性	比重	3.6	
	粘度	11000~13000 cP	
	チクソ性	5.5	
	オープンタイム	24時間	
	有効保存期間	1年間 (-40℃)	
硬化条件	オープン硬化	90分×150℃	
ペースト塗布方法	スタンピング	○	
	ディスペンス	○	
硬化物の物性	ガラス転移点	125℃	
	熱膨張係数	α1	ガラス転移点前 $35 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
		α2	ガラス転移点后 $125 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
	体積抵抗値1)	$0.1 \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$	
	熱伝導率1)	25 W/m·K	
	ダイシェア強度1)2)	25℃	15 kgf/die
260℃		1.2 kgf/die	

1)硬化条件：オープン硬化 90分×150℃
2)1.5 mm角Siチップ、Ag/Cu基板使用